



達興材料股份有限公司

股票代碼：5234

法人說明會

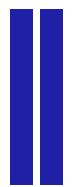
2026.08.14





免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得之前瞻性資訊。本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些前瞻性陳述有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險及不確定性。
- 本簡報中對未來的展望，是基於本公司目前可得資訊對未來事件的期望和預測，未來若有任何變更或調整時，本公司將不承擔隨時提醒或更新之責任。



簡報大綱

- ◆ 公司簡介
- ◆ 經營成果
- ◆ 未來展望

公司簡介





公司基本資料



創立日期

2006年7月12日
(友達光電及長興材料合資成立)

資本額

新臺幣10.27億

員工人數

截至2026年7月之員工人數為 450 人
研發人員 > 50%

上市日期

2012年7月16日 (股票代號：5234)

合併營收

2025年：46.30億

主要營業項目

半導體材料
顯示器材料
關鍵原材料
其他特用精細化學材料



主要產品

半導體材料

- 用途: 應用於晶圓製程及封裝製程之直接永久材料及間接製程材料
- 產品: 有機離型層、剝離液、高純度溶劑、蝕刻液、特用保護膠材等

顯示器材料

- 用途: 應用於LCD Array, Cell, Color Filter之直接永久材料及間接製程材料
- 產品: 光阻、配向膜、蝕刻液、光學膠、保護層、濕式化學品等

關鍵原材料

- 用途: 應用於綠能產業及化學相關應用之上游關鍵原料
- 產品: 特用單體、壓克力高分子、鋰電池矽負極高分子等

經營成果



合併綜合損益表-1

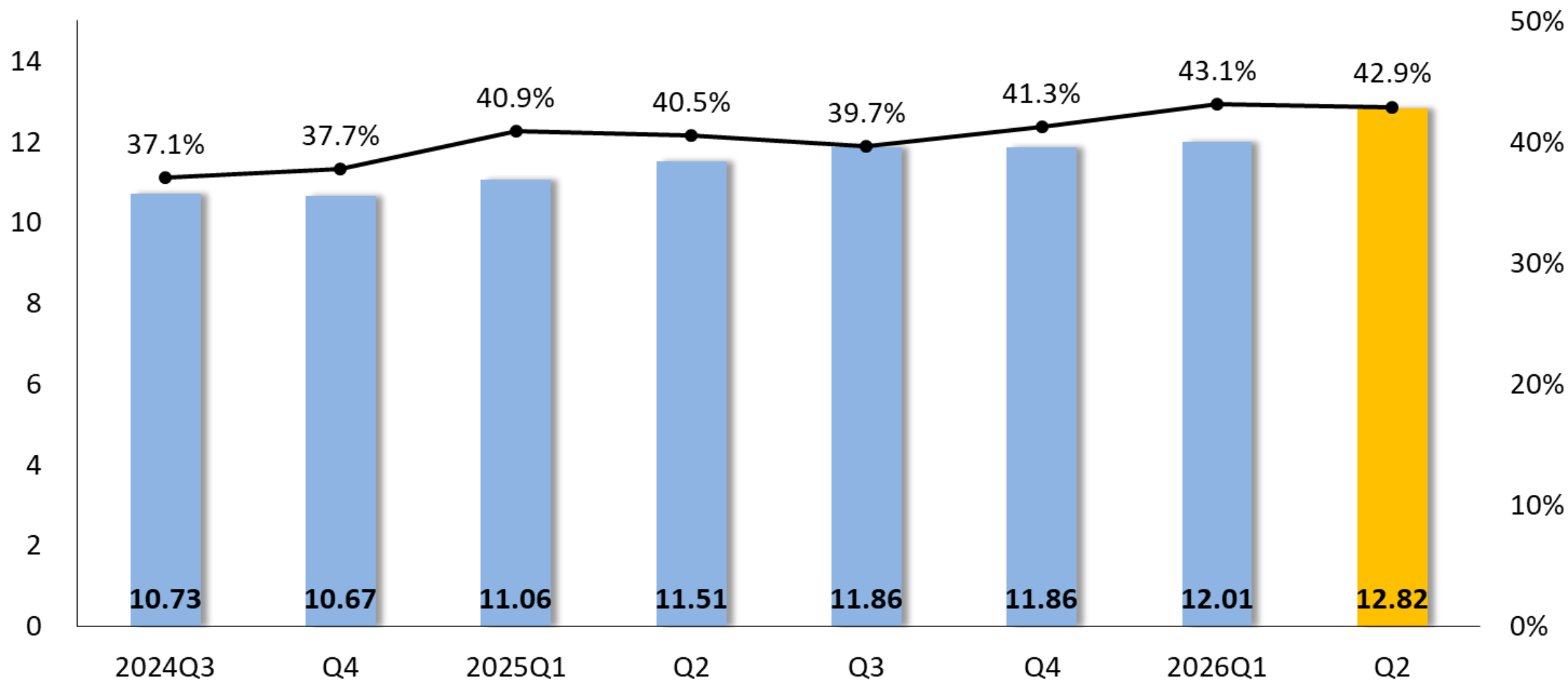
Unit : NTD M	2026 Q2		2026 Q1		QoQ	2025 Q2		YoY
營業收入	1,281.7	100.0%	1,201.3	100.0%	6.7%	1,151.1	100.0%	11.3%
營業成本	731.8	57.1%	683.5	56.9%	7.1%	684.5	59.5%	6.9%
營業毛利	549.9	42.9%	517.8	43.1%	6.2%	466.5	40.5%	17.9%
銷售費用	56.2	4.4%	56.1	4.7%	0.2%	53.1	4.6%	5.9%
管理費用	76.9	6.0%	70.0	5.8%	9.9%	57.6	5.0%	33.6%
研發費用	159.4	12.4%	150.3	12.5%	6.0%	135.2	11.7%	17.9%
營業費用	292.5	22.8%	276.4	23.0%	5.8%	245.8	21.4%	19.0%
營業淨利	257.5	20.1%	241.4	20.1%	6.6%	220.7	19.2%	16.6%
營業外收(支)	7.4	0.6%	24.1	2.0%	(69.4%)	(34.7)	(3.0%)	(121.3%)
稅前淨利	264.8	20.7%	265.5	22.1%	(0.3%)	186.0	16.2%	42.4%
所得稅費用	36.0	2.8%	38.5	3.2%	(6.4%)	26.7	2.3%	35.0%
本期淨利	228.8	17.9%	227.0	18.9%	0.8%	159.4	13.8%	43.6%
其他綜合損益	(0.4)	0.0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%
綜合損益總額	228.4	17.8%	227.0	18.9%	0.6%	159.4	13.8%	43.3%
基本每股盈餘 (NTD)	2.23		2.21			1.55		

合併綜合損益表-2

Unit : NTD M	2026 H1		2025 H1		年成長
營業收入	2,483.0	100.0%	2,257.1	100.0%	10.0%
營業成本	1,415.3	57.0%	1,337.9	59.3%	5.8%
營業毛利	1,067.7	43.0%	919.3	40.7%	16.1%
銷售費用	112.3	4.5%	105.6	4.7%	6.4%
管理費用	146.8	5.9%	116.6	5.2%	25.9%
研發費用	309.7	12.5%	269.9	12.0%	14.7%
營業費用	568.8	22.9%	492.1	21.8%	15.6%
營業淨利	498.9	20.1%	427.2	18.9%	16.8%
營業外收(支)	31.5	1.3%	(15.6)	(0.7%)	(302.2%)
稅前淨利	530.4	21.4%	411.6	18.2%	28.9%
所得稅費用	74.5	3.0%	59.4	2.6%	25.5%
本期淨利	455.8	18.4%	352.2	15.6%	29.4%
其他綜合損益	(0.4)	0.0%	-	0.0%	0.0%
綜合損益總額	455.4	18.3%	352.2	15.6%	29.3%
基本每股盈餘 (NTD)	4.44		3.43		

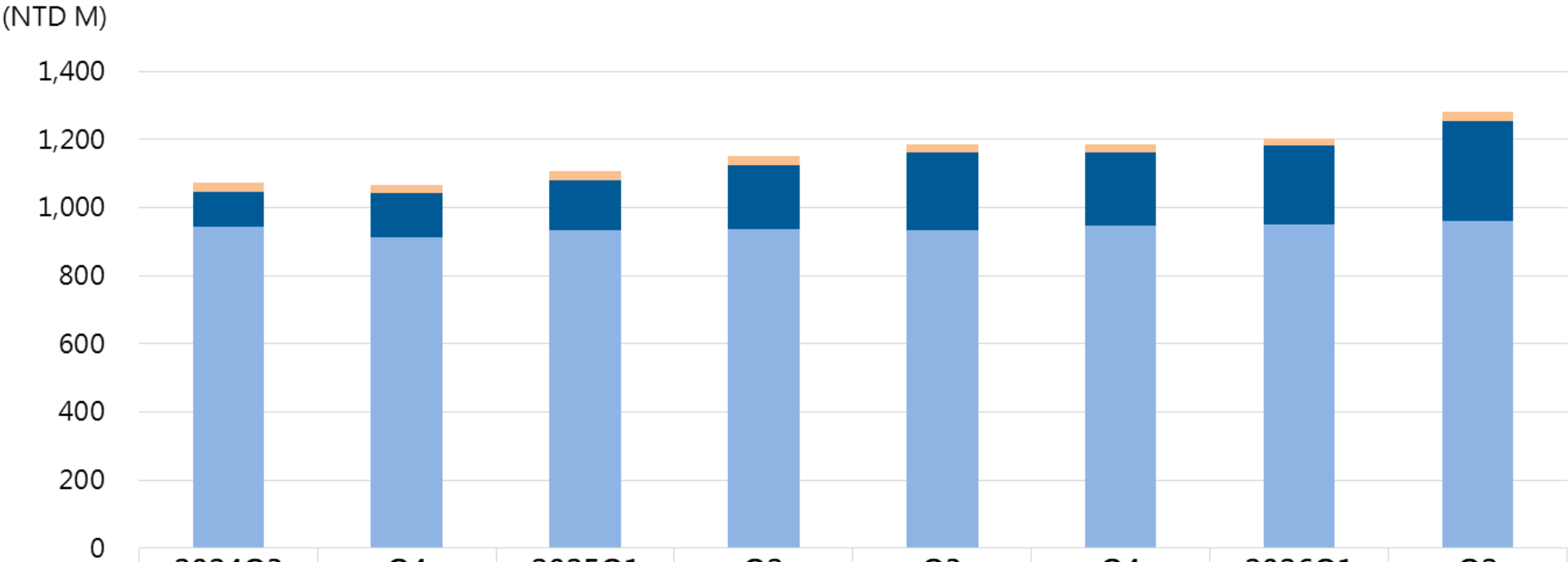
營收及毛利趨勢

NTD 億





產業別營收



	2024Q3	Q4	2025Q1	Q2	Q3	Q4	2026Q1	Q2
關鍵原材料及其他	27.7	25.7	26.7	28.4	26.1	24.9	20.7	29.0
半導體材料	101.1	130.5	147.5	185.7	225.8	214.3	230.6	290.7
顯示器材料	944.7	911.2	931.9	937.0	934.3	947.2	950.0	962.1
TOTAL	1,073.5	1,067.4	1,106.1	1,151.1	1,186.2	1,186.4	1,201.3	1,281.7
關鍵原材料及其他佔比	2.6%	2.4%	2.4%	2.5%	2.2%	2.1%	1.7%	2.3%
半導體材料佔比	9.4%	12.2%	13.3%	16.1%	19.0%	18.1%	19.2%	22.7%



合併資產負債表摘要



Unit: NTD M

	2026/6/30		2026/3/31		2025/6/30	
現金及約當現金	110	2.3%	231	4.4%	266	5.7%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	1,032	21.3%	1,482	28.0%	1,102	23.4%
應收帳款	1,224	25.3%	1,196	22.6%	1,192	25.3%
存貨	482	10.0%	435	8.2%	369	7.8%
採用權益法之投資	45	0.9%	-	0.0%	-	0.0%
不動產、廠房及設備	1,542	31.8%	1,553	29.4%	1,461	31.1%
使用權資產	144	3.0%	146	2.8%	151	3.2%
資產總計	4,841	100.0%	5,288	100.0%	4,703	100.0%
流動負債	1,295	26.8%	2,004	37.9%	1,256	26.7%
非流動負債	230	4.8%	198	3.7%	324	6.9%
負債總計	1,526	31.5%	2,201	41.6%	1,580	33.6%
權益總計	3,315	68.5%	3,087	58.4%	3,123	66.4%

重要財務指標

流動比率%

236%

177%

241%

存貨週轉天數

58

57

51



合併現金流量表摘要



Unit: NTD M	2026 H1	2025 H1
本期稅前淨利	530	412
折舊及攤銷	133	136
營運資金變動	(181)	(169)
營業活動之淨現金流入	411	319
取得不動產、廠房及設備	(187)	(110)
取得採用權益法之投資	(47)	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	345	321
投資活動之淨現金流入	102	222
銀行借款淨變動	22	48
發放現金股利	(668)	(514)
籌資活動之淨現金流出	(650)	(470)
本期現金及約當現金(減少)增加	(137)	71

註：2026/6/30及2025/6/30期末現金及約當現金加計超過三個月以上定存餘額分別為1,142M及 1,367M。



■ 維持高配息政策

年度	EPS	現金股利	股票股利	股利發放比率
2025	7.37	6.5	0.0	88%
2024	5.56	5.0	0.0	90%
2023	5.10	4.1	0.0	80%
2022	4.15	3.3	0.0	80%
2021	6.62	5.3	0.0	80%
2020	6.15	5.0	0.0	81%

未來展望



主要產品

半導體材料

2026/H1
營收占比

21%

◆ 晶圓製程材料

(先進製程, 成熟製程)

◆ 先進封裝材料

(Fan-out, 2.5D, 3DIC)

顯示器材料

77%

◆ LCD材料

(Color Filter, Cell, Array)

◆ MicroLED材料

◆ EPD材料

關鍵原材料

2%

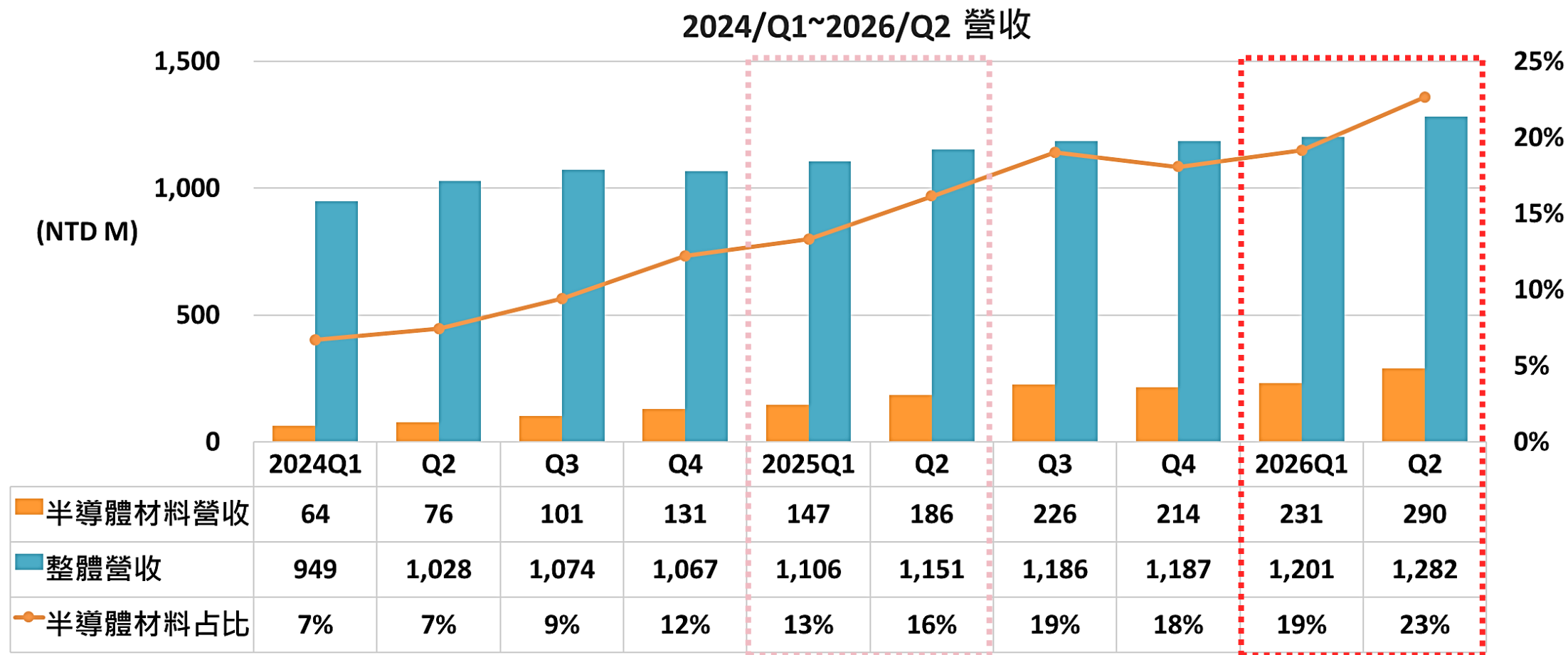
◆ 高機能單體

(電子材料, 顯示器, 生醫)

◆ 高純度高分子

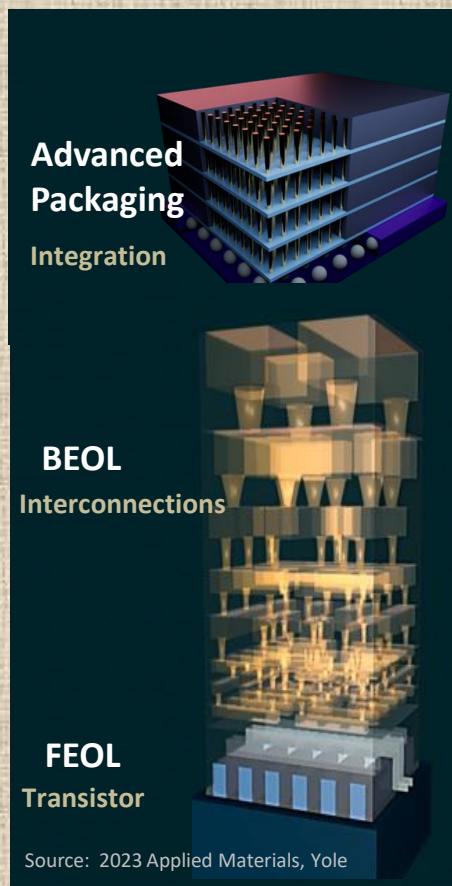
(電子材料, 半導體, 綠能)

半導體材料營收



◆ 半導體 2026 上半年營收 NTD 521M 占比 21%，較去年同期 NTD 333M 成長 56%。

半導體營運成果與計畫



先進封裝

成熟製程

先進製程

自主開發

Specialty – RL
Wet – Etchant A
Litho – PSPI
Specialty – TBA
Wet – Etchant C

Wet – Stripper
Litho – Topcoat
Litho – TARC
Litho – Rinse

Litho – Thinner
Wet – Etchant B
Wet – Remover A
Wet – Remover B
Wet – Remover C
Wet – Etchant C

策略合作

Specialty – Sealant
Wet – Stripper A
Wet – Stripper B

Litho – Polymer A
Litho – Polymer B
Litho – Polymer C

Wet – Stripper C
Wet – Low k treatment
Wet – Protection A
Wet – Protection B
Litho – SiOC
Wet – Cleaner

量產中
測試驗證中
評估中

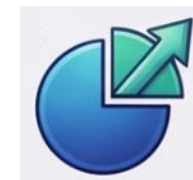
- ◆ 量產品配合客戶需求，新建產線擴充產能。
- ◆ 新產品同步推進導入，預計H2有五項產品上線驗證。
- ◆ 策略合作由單一項目延伸至多元合作模式。

導入製程去瓶頸化的材料設計



高感度PS、高塗速PS、Mura-free PSA PI
協助客戶提升產能與良率

強化可持續的成本競爭壁壘



優化生產製程、提高原料自製比例，
保持PS & Cu蝕刻液優勢、提升市佔率

營收動能 – 液晶配向膜 PI



擴大液晶配向膜 PSA PI導入新量產廠區

擴展新規新產品與應用領域



低溫製程材料 (ESG)、FFS液晶配向膜PI
、膽固醇液晶配向膜



營運展望

半導體材料

- 新增3~4項新產品導入量產
- 精密製造服務及彈性擴充產能

- 新世代先進節點/封裝: 擴大POR導入
- 深化與國際大廠多元策略合作

顯示器材料

- 導入製程去瓶頸化的材料設計
- 提升成本競爭力及市占率

- 推進低溫/低碳排 ESG 綠色材料
- 佈局下世代MicroLED結合光通訊材料

關鍵原材料

- 開發新市場應用領域
- 聚焦高機能特用原材料

- 拓展次世代通訊、生技及綠能領域
- 打造高附加價值的第三大產品線

Q & A



Thank you

